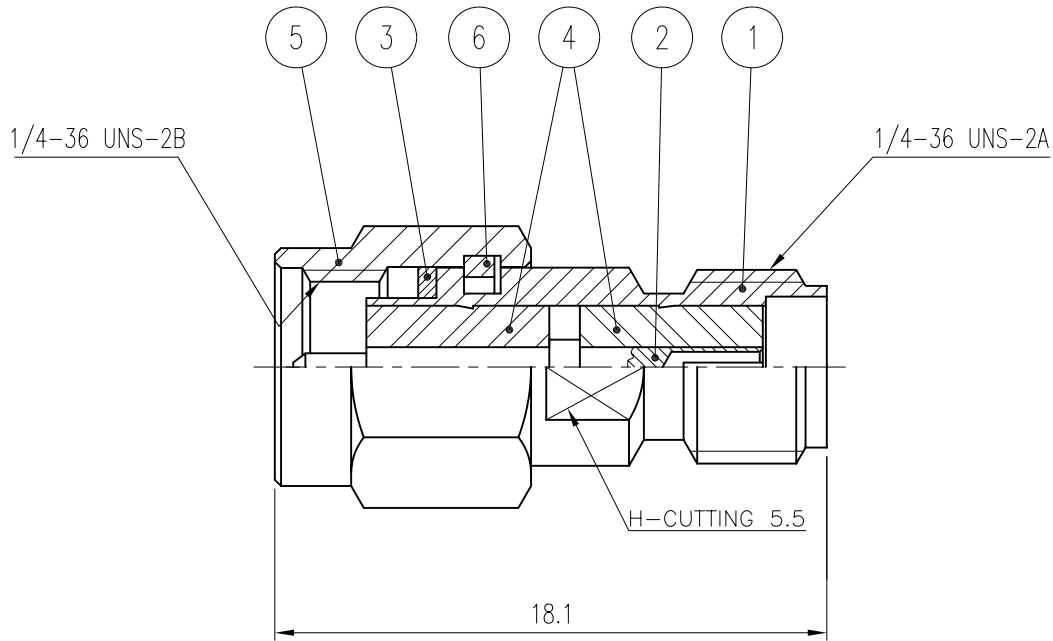


수 정 내 용									
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일					
1	특성 보완	최 종 립	김 기 영	2001. 07. 19.					
2	[설번처리No.201302-0002] 납시배늘 추가	I.C.KIM	I.C.KIM	2013. 02. 04.					



6	SPRING RING	1	SUS	부동태 처리	DSR00002-5/1 (R2001)
5	COUPLING CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00005-5/1 (K2001)
4	INSULATOR	2	TEFLON		DIN02133-N/1 DIN00117-N/1 (H2148)
3	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00004-N/1 (G2001)
2	CONATCT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00095-5/1 (E2065)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00107-5/1 (D2049)

대체가능재질	품번		품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일		2013. 02. 04.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD. SMA-A-JP		
	승인	I. C. KIM					
재질	검도	E. H. KIM			도명		
	재도	I. C. KIM					
열처리	작성부서				연 구 소		
보호파막처리	척도 4/1	단위 mm	중량	A4			
					도번 AD00011-7/1		
					K314-703-000		